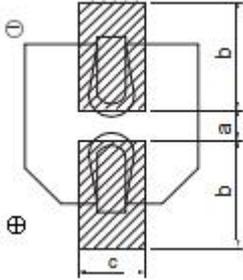


焊盘型式与适用产品尺寸

用于片式电容器的电路板的焊盘图案请参考下述焊盘尺寸，进行电路设计。特别是由于焊盘间距会影响安装强度，因此，请务必仔细确认。

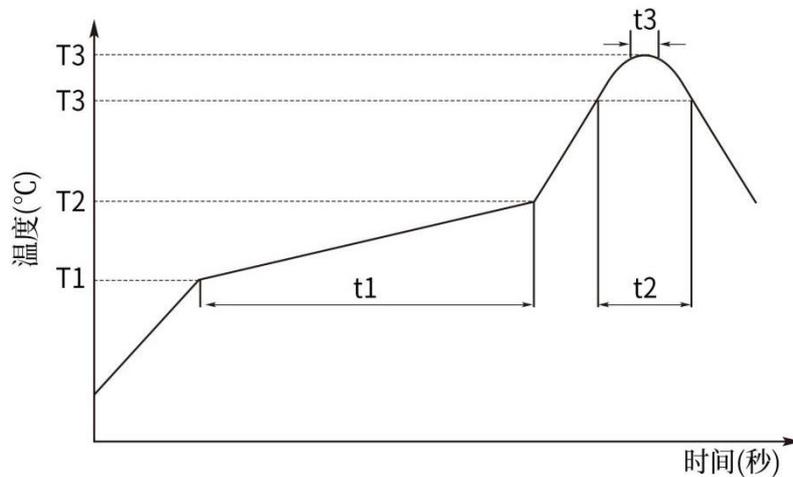


产品尺寸	焊盘尺寸 (mm)		
	a	b	c
4Φ	1.0	2.6	1.6
5Φ	1.4	3.0	1.6
6.3Φ	1.9	3.5	1.6
8Φ	3.0	3.5	2.5
10Φ	4.0	4.0	2.5
12.5Φ	4.0	6.0	3.2
16Φ	6.0	7.0	3.2
18Φ	6.0	8.0	3.2

焊接方法之适用性

焊接方法	回流焊	烙铁	波峰焊
适用性	适用√	适用√	不适用X

无铅回流焊使用条件



产品尺寸 (Φ)		Φ4~Φ6.3X4.5	Φ4~Φ6.3		Φ4~Φ6.3		Φ8~Φ18	Φ8~Φ16
额定电压 (V)		4~100	4~50		≥63		4~100	≥160~450
预热	温度 (T1-T2, °C)	150-180						
	时间 (t1, 秒) (最大)	120	100					
持续时间	温度 (T3, °C)	230	217	230	217	217	230	217
	时间 (t2, 秒) (最大)	30	90	60	60	60	40	40
最高温度	温度 (T4, °C)	260						
	时间 (t3, 秒)	5						
回流焊次数		1	≤ 2					

注：回流焊方式请使用红外线，热风并用，大气等气体介质热传导方式。

回流焊试验方法如下

- (1) 产品于焊接时请依用之温度条件，如使用较高之温度时，请量测并告知电容温度及回流焊条件；
- (2) 制品尺寸较大其上升的温度较缓慢，并非得依制品尺寸别调整回流焊锡炉的温度。
例如：4Φ~18Φ产品皆会安装于 PCB 板过锡炉。

焊锡注意事项

- (3) 回流焊接温度的相关因素
 - ①产品尺寸：产品尺寸较大其温度上知较缓慢；
 - ②制品安装位置：PCB 中心的温度较 PCB 边缘温度低。
- (4) 反复回流焊
 - ①如果非必要，请避免产品进行二次回流焊；
 - ②如果反复回流是不可避免的，请量测第一/二次的回流温度/时间，二次回流温度需冷却至 5-35℃。
- (5) 以铬铁焊锡时请依循下列条件作业
 - ①铬铁最高温度：350±5℃；
 - ②焊接时间：3 +1/-0 秒。